

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成24年11月29日 (2012.11.29)

【公開番号】特開2012-74715(P2012-74715A)

【公開日】平成24年4月12日 (2012.4.12)

【年通号数】公開・登録公報2012-015

【出願番号】特願2011-248901(P2011-248901)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/301 (2006.01)

C 0 9 J 7/02 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/78 M

C 0 9 J 7/02 Z

【手続補正書】

【提出日】平成23年11月18日 (2011.11.18)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

半導体素子、接着剤層、及び支持部材を備え、半導体素子が接着剤層を介して支持部材に接着され、半導体素子の中央部にあたる部分の接着剤層が除去されている半導体装置。